

## 思特威（上海）电子科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，思特威（上海）电子科技股份有限公司将截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意思特威（上海）电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]636号）批准，思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海思特威”）向社会公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，发行价格为31.51元/股，募集资金总额为人民币1,260,715,100.00元，扣除承销商保荐及承销费用人民币63,035,755.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币23,461,118.52元（包括：审计费及验资费人民币9,000,000.00元、律师费人民币9,000,000.00元、用于本次发行的信息披露费用人民币4,716,981.13元、发行手续费及材料制作费等人民币744,137.39元），募集资金净额为人民币1,174,218,226.48元。上述募集资金于2022年5月17日到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具安永华明（2022）验字第61555491\_B03号验资报告验证。

#### （二）前次募集资金的存放及管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护中小投资者利益，本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《思特威（上海）电子科技有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理以及监督等作出了具体明确的规定。

2022年5月，本公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分别与上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区分行、平安银行股份有限公司上海分行、星展银行（中国）有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市徐汇支行、兴业银行股份有限公司上海市北支行及中信银行股份有限公司上海分行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司、全资子公司上海思特威集成电路有限公司和保荐机构中信建投与杭州银行股份有限公司上海分行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

为确保募集资金使用安全，2022年10月，本公司、全资子公司昆山思特威集成电路有限公司开立募集资金存放专用账户，与招商银行股份有限公司上海安亭支行和保荐机构中信建投签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至2025年12月31日，上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议履行正常。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行上述协议，保证专款专用。

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金在各银行专户的存储情况如下：

金额单位：人民币万元

公司	开户银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日金额	备注
思特威（上海）电子科技有限公司	杭州银行股份有限公司上海分行	31010401600 02165394	0.00	0.00	已销户
思特威（上海）电子科技有限公司	杭州银行股份有限公司上海分行	31010401600 02165402	0.00	0.00	已销户
思特威（上海）电子科技有限公司	上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区分行	50131000895 526847	0.00	0.00	已销户

公司	开户银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日金额	备注
思特威（上海）电子科技股份有限公司	平安银行股份有限公司上海分行	15655388888808	119,767.93	0.00	已销户
思特威（上海）电子科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海安亭支行	121935449810507	0.00	0.00	已销户
思特威（上海）电子科技股份有限公司	星展银行（中国）有限公司上海分行	30020164388	0.00	0.00	已销户
思特威（上海）电子科技股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市徐汇支行	454682861761	0.00	0.00	已销户
思特威（上海）电子科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海市北支行	216200100151688213	0.00	0.00	已销户
思特威（上海）电子科技股份有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	8110201012601459859	0.00	0.00	已销户
昆山思特威集成电路有限公司	招商银行股份有限公司上海安亭支行	121943335310358	0.00（注1）	0.00	已销户
<b>合计</b>			<b>119,767.93</b>	<b>0.00</b>	

注1：2022年10月，公司第一届董事会第十四次会议审议同意将募投项目“思特威（昆山）电子科技有限公司图像传感器芯片测试项目”实施主体由思特威（昆山）电子科技有限公司变更为昆山思特威集成电路有限公司。为规范公司募集资金管理和使用，保证募集资金投资计划的正常进行，本公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司及昆山思特威集成电路有限公司于2022年10月与招商银行股份有限公司上海安亭支行签订了《募集资金四方监管协议》，由公司全资子公司昆山思特威集成电路有限公司在招商银行股份有限公司上海安亭支行开立账号为121943335310358的募集资金专户。

注2：初始存放金额与前次发行募集资金净额差异系上网发行费、申报会计师费、律师费、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用，减除后，公司前次募集资金净额为11,7421.82万元。

注3：上述募集资金账户已全部销户。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### （一）前次募集资金使用情况对照表

截至2025年12月31日止，公司首次向社会公众公开发行股票募集资金已全部使用完毕，具体情况如下：

项目	金额（人民币元）
----	----------

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	1,260,715,100.00
减：保荐承销费	63,035,755.00
实际收到的募集资金总额	1,197,679,345.00
减：其他发行费用	23,461,118.52
实际募集资金净额	1,174,218,226.48
减：以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金	760,351,114.78
减：募投项目支出	414,342,634.19
减：手续费	3,937.07
加：利息收入	7,246,450.69
减：募集资金节余永久补充流动资金	6,766,991.13
募集资金期末余额	0.00

截至 2025 年 12 月 31 日，前次募集资金使用情况详见附表 1：《前次募集资金使用情况对照表》。

## （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

2023 年 4 月 28 日，本公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资总额及变更部分募投项目实施地点、实施方式的议案》，将该项目的实施地点由“江苏省昆山市开发区前进东路北侧、富春江路东侧”变更为“江苏省昆山市锦溪镇锦顺路 188 号”，实施方式由“在昆山经济技术开发区建设测试厂房，搭建无尘车间，购买测试设备”变更为“在昆山经济技术开发区租赁测试厂房，搭建无尘车间，购买测试设备”。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整募投项目投资总额及变更部分募投项目实施地点、实施方式的公告》（公告编号：2023-009）。上述事项于 2023 年 6 月 16 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过。

## （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2022 年 7 月 8 日，本公司召开了第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同

意公司使用募集资金 76,035.11 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构中信建投出具了无异议的核查意见。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《思特威（上海）电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2022）专字第 61555491\_B07 号）。截至 2022 年 12 月 31 日，上述金额均已置换转出。

#### **（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### **（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

2023 年 8 月 25 日，本公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用最高不超过人民币 6,500 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，自 2023 年 9 月 1 日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。本公司独立董事、监事会、保荐机构中信建投已分别对此发表了明确同意意见。

2024 年 8 月 23 日，本公司分别召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用最高不超过人民币 3,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，自 2024 年 9 月 1 日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。本公司监事会、保荐机构中信建投已分别对此发表了明确同意意见。

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

## **（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

## **（七）前次募集资金结余及结余募集资金使用情况**

2024 年 12 月 26 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，截至 2024 年 12 月 18 日，本公司募投项目“研发中心设备与系统建设项目”、“图像传感器芯片测试项目”、“CMOS 图像传感器芯片升级及产业化项目”均已达到预定可使用状态，本公司决定将其予以结项。截至 2024 年 12 月 31 日，本公司合计节余募集资金 676.70 万元，已用于永久补充流动资金并使用完毕。

另外，由于银行结息日为季度末 20 日或 21 日，部分募集资金专用银行账户新增 2024 年 12 月 21 日或 22 日至 2025 年 1 月销户日期间的结息，扣除手续费后为 1,631.71 元，已用于永久补充流动资金并使用完毕。

## **（八）募集资金使用的其他情况**

### **1、调整项目拟投入募集资金金额和增加项目实施主体**

2022 年 7 月 8 日，公司召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》，同意调整募集资金投资项目“研发中心设备与系统建设项目”和“CMOS 图像传感器芯片产品升级及产业化项目”的实施主体，增加了思特威（上海）电子科技股份有限公司和上海思特威集成电路有限公司为实施主体。

2022 年 7 月 8 日，公司召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。由于公司发行募集资金净额低于《思特威（上海）电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对募投项目拟投入募集资金的金额进行调整。

## 2、项目实施主体和名称变更

2022年10月，本公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向子公司增资的议案》，同意将募投项目“思特威（昆山）电子科技有限公司图像传感器芯片测试项目”实施主体由思特威（昆山）电子科技有限公司变更为昆山思特威集成电路有限公司，并将该募投项目名称变更为“图像传感器芯片测试项目”，同意本公司使用募集资金人民币3,000万元向全资子公司昆山思特威集成电路有限公司增资，用于实施图像传感器芯片测试项目相关业务。

该项目实施主体和名称变更有关事项未改变募集资金的使用方向，且新的实施主体昆山思特威集成电路有限公司为公司的全资子公司，因此不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则指引第1号——规范运作》的规定。

截至2025年12月31日，除上述情形外，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

## 三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2025年12月31日止，前次募集资金投资项目产生的效益情况详见附表2：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

研发中心设备与系统建设项目、图像传感器芯片测试项目作为公司研发能力提升及产品品质保障的相关项目，主要用于支撑公司业务发展，是基础性功能性投入，有助于提高公司运营效率及产品品质，增强客户服务能力，提高竞争壁垒，但不产生直接的经济效益。

补充流动资金项目将进一步优化公司财务结构和现金流状况，为公司主营业务相关的经营提供资金支持，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。

上述募集资金投资项目均无法单独核算收益，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。

### **（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况**

无。

## **四、前次募集资金投资项目的资产运行情况**

公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

## **五、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

## **六、报告的批准报出**

本报告于 2026 年 3 月 27 日经董事会批准报出。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

思特威（上海）电子科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日

附表 1

## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

募集资金总额（注 1）			117,421.82			已累计使用募集资金				117,469.38
累计变更用途的募集资金总额			0.00%			各年度使用募集资金	2022 年度		107,899.19	
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%				2023 年度		4,717.89	
							2024 年度		4,852.30	
							2025 年度		0.00	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	调整后承诺投资金额（注 2）	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额（注 3）	实际投资金额（注 4）	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	研发中心设备与系统建设项目	研发中心设备与系统建设项目	73,466.10	50,000.00	49,796.76	73,466.10	50,000.00	49,796.76	-203.24	已结项
2	图像传感器芯片测试项目	图像传感器芯片测试项目	40,868.94	3,000.00	2,999.92	40,868.94	3,000.00	2,999.92	-0.08	已结项
3	CMOS 图像传感器芯片升级及产业化项目	CMOS 图像传感器芯片升级及产业化项目	88,708.26	35,000.00	35,124.65	88,708.26	35,000.00	35,124.65	124.65（注 5）	已结项
4	补充流动资金	补充流动资金	79,000.00	29,421.82	29,548.05	79,000.00	29,421.82	29,548.05	126.23	不适用

<b>合计</b>	<b>282,043.30</b>	<b>117,421.82</b>	<b>117,469.38</b>	<b>282,043.30</b>	<b>117,469.38</b>	<b>117,469.38</b>	<b>47.56</b>	<b>-</b>
-----------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	----------

注 1：“募集资金总额”已扣除相关的发行费用。

注 2：2022 年 7 月 8 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投对此事项发表了无异议的核查意见。公司于 2022 年 7 月 12 日披露了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-002）。

注 3：“实际投资金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 4：“截至期末累计投入金额”包括募集资金到账后“累计投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 5：CMOS 图像传感器芯片升级及产业化项目以及补充流动资金截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的差额系利息收入投入导致。

附表 2

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2025 年 12 月 31 日

单位：人民币亿元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023 年	2024 年	2025 年		
1	研发中心设备与系统建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	图像传感器芯片测试项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	CMOS 图像传感器芯片升级及产业化项目（注 2）	不适用（注 1）	82.74	16.71	21.50	31.78	86.63	是
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：公司为芯片设计企业，采用 Fabless 模式，无产能概念。

注 2：公司前次募投项目未承诺效益，按照预期实现的产品收入计算。